

射线源：额定功率	135 W
扫描支持功能：三维 CT 扫描 区域显示功能	有
动力源:接地	D 种接地（接地阻抗不超过 100 Ω ）
动力源: 控制计算机	100 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 1.5 kVA
动力源: 主机	200 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 3 kVA
专用桌尺寸和质量	W1,200 $\times$ D700 $\times$ H1,270 mm, 约 60 kg
防护箱尺寸和质量	W2,170 $\times$ D1,350 $\times$ H1,857 mm, 约 3,100 kg
安全装置	铅房屏蔽电压、防冲碰撞传感器
CT 数据采集时间	10 秒~60 分钟之间任意设置
扫描模式	Normal 扫描、Half 扫描、Offset 扫描, FS 扫描* ¹ , 2DCT 扫描* ² 、CB（锥束）CT 扫描* ³
扫描支持功能：全自动 CT 扫描	有
3DFOV 功能* ⁴	有
扫描支持功能：通过外部摄像头定位	有
射线源 :X 射线管电压	225 kV
空间分辨能力	4 μ m
最大 CT 图像尺寸 :Cone-Beam CT	4,096 $\times$ 4,096

最大 CT 图像尺寸 :Two-Dimensional CT	4,096 × 4,096
图像显示	设备自带断层扫描图像显示功能，在不借助第三方软件的情况下也能使用并获得样品的任意断层图片
重建速度	系统可以高速重建高分辨率 CT 图像，并且可以在采集数据的同时重建图像，所以，数据采集完成后最快 5 ~ 10 秒就可同时重建出数百幅断面图像。（1024*1024 分辨率下，数据采集后，最快可以 10 秒内得到图像。
工件最大质量	12kg
最大工件尺寸和 CT 扫描区域	Φ400mm XH300mm
探测器最大输入分辨率 (offset 模式下)	约 14,000,000 像素
X 射线探测器灰度	16-bit = 65,536 shades of gray
X 射线探测器尺寸、像素尺寸	16 inch、139μm
探测器有效像素	3000X3000
X 射线探测器	平板检出器
射线泄漏	1 μSv/h max.

本设备外壳上的型号仍为 “inspexio SMX-225CT FPD HR” ， 控制软件名称”

InspeXio64ver.3.0” 后面增加了后缀 “Plus”

*1 FS 扫描：扇形（FS）扫描通过以 60、90 和 120 度旋转角度扫描样本来获得 CT 图像。

*2 2DCT：二维计算机断层扫描（2DCT）从每次 CT 扫描中获得一张或三张 CT 图像。

*3 CBCT：锥束计算机断层扫描（CBCT）从每次 CT 扫描中获得数百张 CT 图像。

*4 3DFOV 功能：一次扫描完成后可在 CT 图像上进行再次定位。